

Inhalt

		Seite
<i>M. Reithinger</i>	SMT-Montage in der Flachbaugruppenfertigung – heute und morgen	1
<i>K. Feldmann</i>	Neue Herausforderungen an die Elektronikfertigung durch technische Innovation	21
<i>G. Förster</i>	Strukturierung dreidimensionaler Schaltungsträger	37
<i>E. Leipe</i>	MID-Technik in der Telekommunikation	51
<i>D. Manz</i>	Wirtschaftliche Exotenbestückung mit Robotern	69
<i>G. Schiebel</i>	Wichtige Kriterien bei SMD-Bestückautomaten in Richtung Verarbeitung extremer Gehäuseformen	81
<i>J. van Gastel</i>	ALERT: Advanced Laser Reflow Soldering for Surface Mount Technology	107
<i>H. Boyer</i>	Löten mit N ₂ und gasförmigen Aktivatoren	129
<i>W. Sauer</i>	Ein optimaler Qualitätsregelkreis für die SMD-Bestückung	139
<i>B. Rösner</i>	„Chip on board“ Probleme und Lösungsvorschläge	149
<i>J. Sturm</i>	Technisch-wirtschaftliche Bewertung alternativer Prüfkonzepte für die Elektronikbaugruppenfertigung	169
<i>Th. Hartmann</i>	Optische Inspektion	181

Podiumsdiskussion III

Null Fehler durch prozeßbegleitendes Prüfen – Ende der konventionellen Prüftechnik???

<i>H. Scheler</i>	NULL-Fehler durch prozeßbegleitendes Prüfen. Ende der konventionellen Prüftechnik?	207
<i>D. Sankaran</i>	Baugruppentest (Podiums-Statement)	211
<i>S. Hornig</i>	Konventionelle Prüftechnik im Wandel der Zeit	217

		Seite
<i>E. Gailling</i>	SMD-Prozeßmeß- und Prüftechnik	219
<i>R. Lindner</i>	Praktische Erfahrung beim Einsatz von Boundary Scan an einem komplexen Telekommunikationsboard	229
<i>V. Schöber</i>	Ein neues Boundary-Scan-Konzept für den hierarchischen Test von Leiterplatten	241
<i>H.-W. Gillmann</i>	Neue Testverfahren beim In-Circuit-Test; Anforderungen, Konzepte, Ergebnisse	259
<i>J. Timmers</i>	Integrated Design and Test Environment	273
<hr/>		
	Referenten, Diskussionsleiter und Programmausschuß	283